

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

**厦门恒坤新材料科技股份有限公司拟与合肥新站高新技术
产业开发区签订〈恒坤半导体先进材料项目投资合作协议〉
的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥新站高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟于 2021 年 2 月签署《恒坤半导体先进材料项目投资合作协议》（暂定名，正式协议名称以实际签署为准）。根据《恒坤半导体先进材料项目投资合作协议》，本次投资项目主要为集成电路用光刻胶及超高纯前驱体等半导体材料的研发生产，拟投资总额不超过 3.50 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“公众公司及其他控股或者控制的公司购买、出售资产、达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最

近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

本次投资目前为意向阶段，暂无实际投资时间表或相关进程安排。同时，根据前期判断，本次投资主要涉及资产类别为购买土地使用权与新建工业厂房。因此，本次投资项目现阶段不构成重大资产重组。如后期拟发生设备采购等涉及重组指标的行为，公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规履行事前审议程序与信息披露义务，如相关采购拟触发重大资产重组，公司将严格按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规执行。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过关于《公司拟与合肥新站高新技术产业开发区签订<恒坤半导体先进材料项目投资合作协议>》议案，此议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥新站高新技术产业开发区管理委员会

住所：合肥文忠路 999 号

法定代表人：王连贵

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目建设内容：集成电路用光刻胶及超高纯前驱体等半导体材料的研发生产。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在合肥新站高新技术产业开发区投资建设集成电路用光刻胶及超高纯前驱体等半导体材料的研发生产项目，拟投资总额为不超过 3.50 亿元。公司拟以子公司为经营责任主体负责本项目的投资建设运营及不动产权证书办理，并在合肥新站高新区辖区内纳税，履行本协议既定事项。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本项目的建设主要是根据长远发展需要，项目建成后有利于公司拓展业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司的长远发展作出的决策，且是与相关政府部门展开合作，在此前提下，本次投资风险相对可控；但市场变化有多方面因素的影响，项目实际建设、竞争对手变化等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，为公司将来的持续发展提供良好的工作环境，有利于提高公司的竞争力，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日